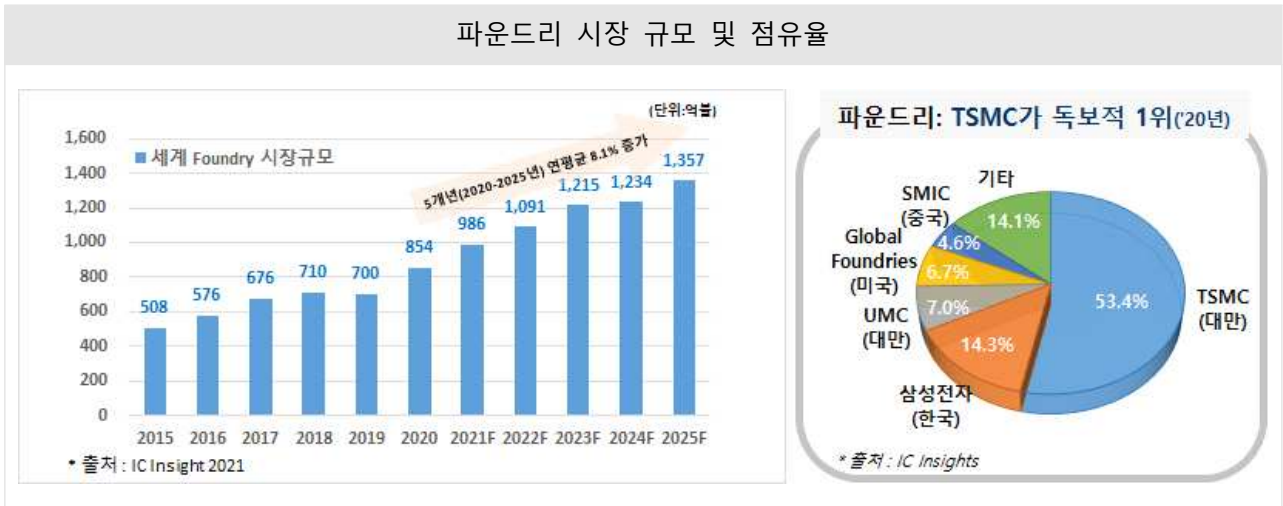


1. 시장동향

1. 글로벌 파운드리 산업 현황

○ 파운드리 산업 현황

■ '21년 세계 파운드리 시장은 986억불로 전년대비 15% 성장 예상되며, 향후 연평균 8.1% 성장하여 '25년에는 1,357억 달러 이상에 이를 전망



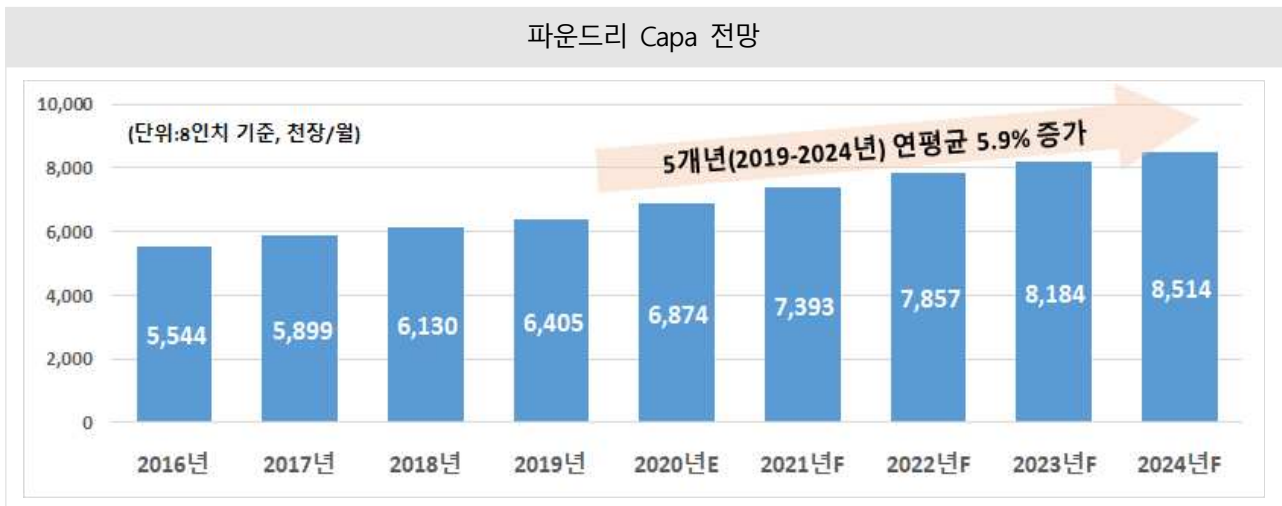
- 현재 파운드리 시장은 상위 10개 기업이 전체의 90% 이상을 차지하고 있으며, 이 중 TSMC(臺)는 시장점유율 50% 이상으로 1社 독주 체제
- 향후, TSMC, 삼성전자가 7nm 이하 초미세공정* 물량을 양분하고, 8인치는 생산 능력, 비즈니스 노하우를 보유한 기업순으로 선점 예상

회사명	유형	국가	Tech (Logic기준)	점유율(%)			
				2017년	2018년	2019년	2020년
TSMC	Pure-play	대만	5nm	47.6	48.2	49.6	53.4
삼성전자	IDM	한국	5nm	14.5	14.2	14.9	14.3
UMC	Pure-play	대만	22nm	7.2	7.1	6.9	7.0
Global Foundries	Pure-play	미국	12nm	9.1	8.7	8.3	6.7
SMIC	Pure-play	중국	14nm	4.6	4.7	4.5	4.6
Hua hong	Pure-play	중국	90nm	2.1	2.3	2.3	2.0
Powerchip	Pure-play	대만	40nm	2.2	2.3	1.7	1.8
TowerJazz	Pure-play	이스라엘	45nm	2.1	1.8	1.8	1.5
Vanguard	Pure-play	대만	110nm	1.2	1.4	1.3	1.3
WIN	Pure-play	대만	100nm	0.8	0.8	1.0	1.0
DB하이텍	Pure-play	한국	90nm	0.9	0.9	1.0	0.9

* IDM Foundry : 자사 제품도 생산하는 파운드리, Pure-Foundry : 외주 생산만 하는 파운드리

* 출처 : IC Insights, Trendforce

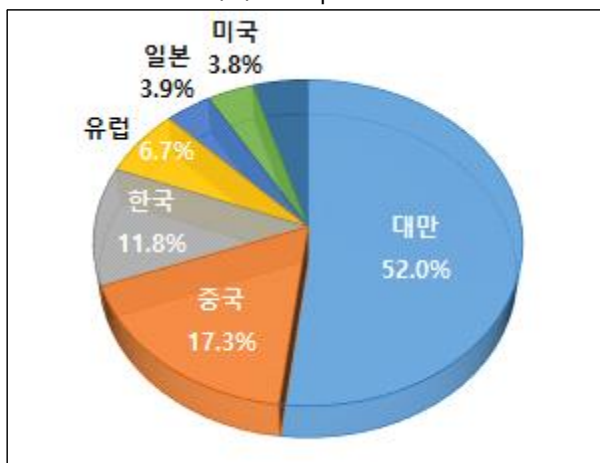
- (Capa-공급) 수요 대응을 위한 파운드리 Fab 확대, 기술발전으로 파운드리 생산능력은 '24년까지 연평균 5.9% 증가할 것으로 전망



자료 | Gartner

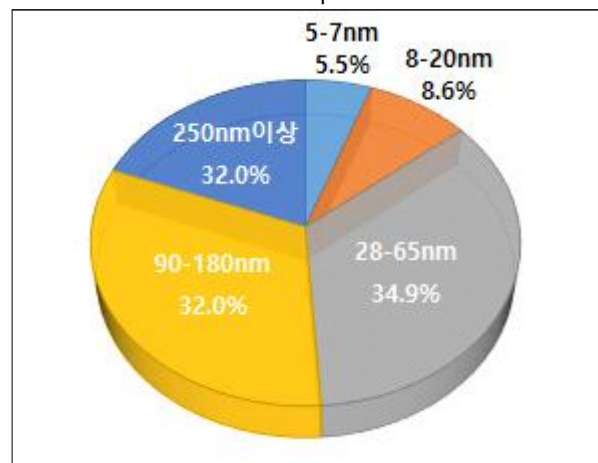
- (Wafer Size별) 파운드리용 웨이퍼는 8인치, 12인치가 주력으로 '20년 기준 8인치가 전체 Capa의 45.5%, 12인치가 48.1%를 차지
 - * Wafer Size별 Capa('20년, Gartner) : 8인치 3.1만장/월, 12인치 3.3만장/월(8인치 환산 기준)
 - * 8인치 제품 가격이 12인치보다 낮아 상대적으로 효율성이 낮고, 8인치 장비 조달의 어려움으로 인해 일반적으로 8인치보다 12인 용량이 확장되는 추세
- (지역별) 대만이 전체 Capa의 절반 이상을 차지, 중국은 他國기업의 중국 현지 공장 영향 등으로 17.3%로 2위, 한국은 11.8%로 3위
 - * 지역별 Capa 비중('20년, Gartner) : 대만 52.0%, 중국 17.3%, 한국 11.8%, 유럽 6.7% 등
 - * 대만의 TSMC, UMC 등이 중국 현지 파운드리 공장 보유
- (Tech별) TSMC, 삼성전자만이 생산 가능한 3-7nm 비중은 아직 10% 미만에 불과하지만 증가 추세이며, 고부가가치로 매출에서는 높은 비중
 - * 전체 매출 중 5nm/7nm의 비중은 '20년 기준 23.7%에 이를 것으로 추정(Gartner)

<지역별 Capa 현황>



자료 | Gartner('21년)

<Tech별 Capa 현황>



- (수요) 파운드리에서 생산하는 반도체는 메모리, 마이크로컴포넌트, Logic, Analog, Discrete 등이 있으나 이 중 Logic의 비중이 압도적
 - * 파운드리 매출 품목별 비중('20년, Gartner) : Logic 75.6%, Analog 10.3%, Microcomponent 5.7%
 - Logic을 포함한 시스템반도체 시장은 AI, IoT, 자율차, 5G 등 미래 新산업의 핵심으로 '24년까지 연평균 3.9%의 지속적인 시장 확대 전망
 - * 시스템반도체 시장 전망(억\$, OMDIA) : ('20) 2,665 → ('22) 2,907 → ('24) 3,108
 - 주요 고객은 팹리스 업체들로서 퀄컴, 엔비디아, 미디어텍, AMD, Hisilicon 등 상위 10개 업체가 전체 팹리스 매출의 약 70% 차지
 - * 파운드리 고객별 비중(% , Gartner) : 팹리스 75%, IDM 9%, System/OEM 16%
 - 파운드리 매출은 무선통신 분야에서 47%로 가장 많이 발생되며 이는 팹리스 고객의 산업을 반영한 결과
 - * 파운드리 산업별 비중(% , OMDIA) : 무선통신 47%, 컨슈머 18%, 산업용 14%, 컴퓨팅 11%, 자동차 7%
- (공급부족) 5G, 자율주행차, IoT 등의 확대에 따라 수요 폭증하는 가운데 단기간 내 파운드리 Capa 증가는 어려운 상황

구 분	현 황
12인치 첨단공정	→ 7나노 이하 첨단공정에서는 네덜란드의 ASML만이 생산 가능한 EUV(극자외선) 장비가 필수적이나 연간 30~40대 규모만 생산 가능 * ASML EUV 장비 생산대수 : ('18) 18대 → ('19) 26대 → ('20) 35대 → 미세화 난이도 증가와 함께 높아지는 투자비용 또한 부담
8인치	→ 최근 8인치 시장은 전자 제품과 자동차 시장 수요 점증하여 PMIC, DDI, CIS 등의 수요 급증 → 반면, Applied Materials나 램리서치, Axcelis 등 주요 장비 업체는 이미 '13년 이전부터 8인치 장비 생산을 중단했기 때문에 장비 조달의 어려워 증설은 쉽지 않은 상황 → 또한 시장이 호황이긴 하나, 상대적으로 12인치보다 수익성이 낮은 8인치 팹에 적극적인 투자가 부담되는 상황

- 더불어 최근의 각종 정전 및 화재로 인해 공급부족은 더욱 심화
 - * '21.1월 대만 UMC의 신주 8인치 팹에서 정전 발생
 - '21.2월 삼성전자 오스틴공장(12인치)은 한파로 인해 정전 발생하여 6주간 섯다운
- ⇒ 8인치 단가 지속 상승중이며 현재의 공급부족 상황은 향후 2~3년간 지속될 것으로 전망

○ 해외 파운드리 기업 현황

■ 대만 TSMC, UMC가 전체 파운드리 시장의 60%이상 차지

* 기업별 점유율('20, IC Insights) : TSMC(53.4) UMC(7.0) GlobalFoundries(6.7), SMIC(4.6)

국내 파운드리 기업 현황			
(Capa : Full Capa 기준)			
업체명	Fab 위치	생산제품	현황
TSMC	대만(신주, 타이중, 타이난) 미국, 중국	8인치 53만장 12인치 84.5만장 5 ~ 450nm	· 세계 1위의 파운드리 업체로 5nm/7nm 첨단 공정 보유 · 최근 연이은 대규모 투자 계획 발표
UMC	대만(신주, 타이난), 일본, 싱가포르, 중국	8인치 33.7만장 12인치 26.2만장 22 ~ 180nm	· 8인치 공급부족에 따른 업황 호조 등으로 최근 3위의 파운드리 기업으로 등극
Global Foundries	미국, 독일, 싱가포르	8인치 10.8만장 12인치 21.4만장 12 ~ 180nm	· 최근 7nm 공정개발 포기하고 12/14nm 중심으로 포트폴리오 변경
SMIC	중국(베이징, 상하이, 닝보, 선전, 텐진)	8인치 35만장 12인치 16.2만장 14 ~ 150nm	· 세계 5위, 중국 1위의 파운드리 기업 · 미국의 무역제재로 첨단공정 개발에 제약

① (TSMC) HPC*·스마트폰向 매출이 80% 수준, 미세공정 기술력 우위를 기반으로 첨단 수요를 독과점하는 No.1 파운드리 업체

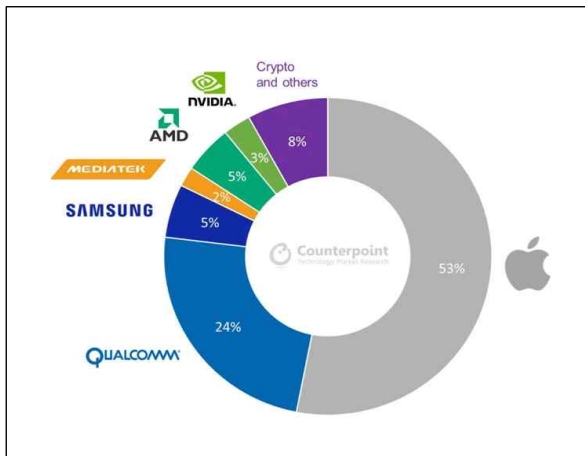
* 87년, 최초로 Pure-play 파운드리 사업 시작

* HPC : 고성능 컴퓨팅(High-performance computing)

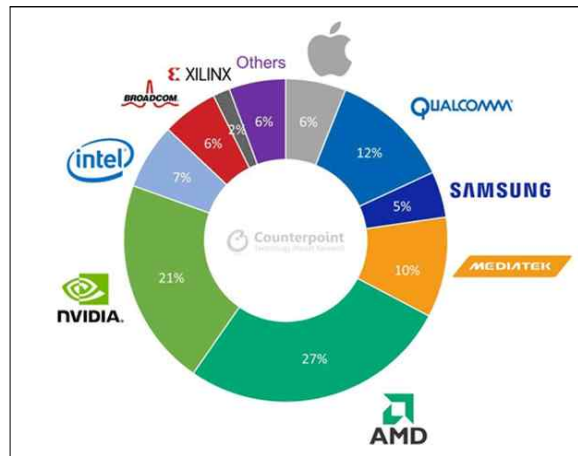
○ 5nm/7nm 첨단노드 생산이 가능한 유익한 업체로서 애플, 퀄컴, 미디어텍, AMD, 엔비디아 등 글로벌 주요 고객사에 물량 공급 중

○ 하이엔드뿐 아니라 Mid-Low end 공정의 모든 제품 분야 커버 가능

<5nm 노드 웨이퍼 출하량 현황>



<7nm 노드 웨이퍼 출하량 현황>



자료 | 카운터포인트('21년)

- 5G 및 스마트폰 칩 수요 호조가 지속되는 가운데, 애플 모바일 AP 'A14', 퀄컴 5G 모뎀칩 '스냅드래곤 X60' 등의 5nm 노드 물량 대량 수주
- '22년 하반기부터 3nm 노드로 애플向 프로세서 양산 계획
- 美獨·日 정부는 파운드리 공급 부족 여파로 'TSMC에 차량용 반도체 생산량 확대를 요청, 이에 TSMC는 최대 15%의 가격 인상 추진

< 최근 TSMC의 투자 관련 발표 >

- ◆ (미국內 팹 건설 발표, '20.5월) '24년 가동을 목표로 120억달러 규모의 5nm 기반 12인치 팹을 미국 애리조나에 건설하겠다고 발표
 - 북미 고객사와의 접근성 확대 및 미중 무역분쟁으로 인한 불확실성을 최소화하기 위한 전략으로 판단
- ◆ (일본內 팹 건설 검토중, '21.1월) 대만 연합보 등 대만 언론은 TSMC가 일본內 공장 건설을 검토하고 있다고 보도
 - 日정부는 '해외 반도체 업체가 일본內 공장을 짓고 일본 업체와 협력할 경우 정부 자금을 지원하겠다' 발표하는 등 파운드리 유치 노력을 지속 중
- ◆ ('21년 시설투자 규모 발표, '21.1월) '20년 172억불 → '21년 250~280억불 계획이며 이는 전년대비 45~63% 증가하는 규모
 - 투자비용의 80%는 선단공정(3,5,7nm) 시설 구축에 활용될 것
 - ①최근 선단공정에서의 공정 전환 비용이 빠르게 증가하고 있고, ②미국 신규 공장 건설 비용 포함, ③'22년부터의 수요 성장에 대비하기 위해 큰 폭의 설비투자 증가
- ◆ (日 후공정 R&D 센터 건설계획 발표, '21.2월) 일본 쓰쿠바시에 반도체 연구개발(R&D) 센터 신설하고 패키징 분야에 초점을 맞춰 연구 진행할 계획
- ◆ (美 팹 투자 규모 증액, '21.3월) 美 애리조나 5nm 팹 투자 계획을 기존 대비 3배(120억불→350억불) 확대
- ◆ (3년간 1,000억달러 투자 계획, '21.4월) 생산능력 확대를 위해 3년간 1,000억달러(약 113조원)를 투자할 계획으로 이는 글로벌 반도체 업체들이 밝힌 투자 중 가장 큰 규모

- ② **UMC** 8인치 웨이퍼 물량에 주력, '19년 4분기 日후지쓰의 300mm Fab 인수하면서 세계 3위 파운드리 업체로 등극
 - 대만·중국·일본·싱가포르에 12인치 Fab 4개, 8인치 Fab 7개, 6인치 Fab 1개를 보유 중이며, Capa는 월 65만장, 최소 노드는 22nm 수준
 - 8인치 업황 호조 속에 가동률이 95~100%에 육박, 최근 도시바 8인치 팹* 인수 검토 중
 - * 일본 오이타시 소재 C-Cubed 팹

- ③ **(글로벌파운드리)** 첨단공정 개발을 잠정 중단하며, 12nm/14nm 등 주력 파운드리 노드 위주로 기술 포트폴리오 재편
- 미국·독일·싱가포르에 12인치 Fab 4개, 8인치 Fab 2개를 보유 중이며, Capa는 월 32만장, 최소 노드는 12nm 수준
 - 글로벌파운드리는 美 몰타 공장 증설을 비롯해 내년까지 14억불 규모의 시설투자 계획 발표, 12~90nm 노드 칩의 생산량 확대할 것으로 보임
 - 재정적 이유(기술개발 비용)로 7nm 공정 개발을 포기를 선언함으로써 선도 기업과의 미세 공정 경쟁은 더이상 어려울 것으로 예상
- ④ **(SMIC)** 중국 유일의 파운드리 업체로서 성숙노드(40,50,180nm)물량이 80% 수준, 미중 무역분쟁이 중장기 리스크로 작용 전망
- SMIC는 파운드리 시장점유율 약 4.5%를 차지(중국 1위, 세계 5위)하고 있으며, 최소 노드는 14nm 수준
 - SMIC 매출의 절반 이상은 내수이며, 주요 해외 고객사인 퀄컴·브로드컴에 8인치 웨이퍼 (0.18 μ m 노드) 기반 파운드리 서비스 중
 - 작년 美 무역 제재로 미국산 장비·부품·원자재의 중국 반입이 제한된 가운데, 非중국 고객들의 주문 철회 문제에 직면 가능성 있음
 - 최근 미국 정부는 반도체 공급 부족 여파로 자국 반도체 장비업체에 대해 중국 수출을 일부 허용*했으나, 성숙노드(14nm 이상) 대상으로 한정
 - 중국 정부 주도 하에 반도체 공급망 국산화를 추진 중이나, 반도체 장비에 대한 美 의존도가 높아 10nm 노드 이하 미세 공정 개발에 차질 우려
 - * 중국내 반도체 장비업체로는 나우라(세정, 증착, 식각), AMEC(증착, 식각), SMEE(노광, 검사), CETGC(이온 주입, CMP) 등이 있으나, 글로벌 경쟁업체들에 비해 경쟁력 떨어짐
- ⑤ **(인텔)** 최근 파운드리 사업 진출을 발표
- 팻 겔싱어 인텔 신임 CEO는 23일(현지시간) 온라인 브리핑을 통해 '인텔 IDM 2.0'비전을 발표
 - 美 애리조나 주에 새로운 공장 2곳을 200억불(22.6조원) 규모의 투자를 통해 신설할 계획이며, 파운드리 서비스 진출 할 것
 - (단기적 영향) High-end 파운드리의 기술장벽 고려시 당분간 TSMC, 삼성전자와의 2강 구도가 유지될 것이며 영향 미미
 - 인텔의 지난 3년간 7nm 양산에 지속 실패해왔으며, 삼성과 TSMC과 경쟁하고 있는 선단공정에서의 경쟁력은 아직 부족
 - * 현재로서 인텔의 EUV 적용 7nm 양산은 '23년 정도로 예상되며, '23년 TSMC와 삼성전자는 3nm 양산 단계로 기술 격차 존재

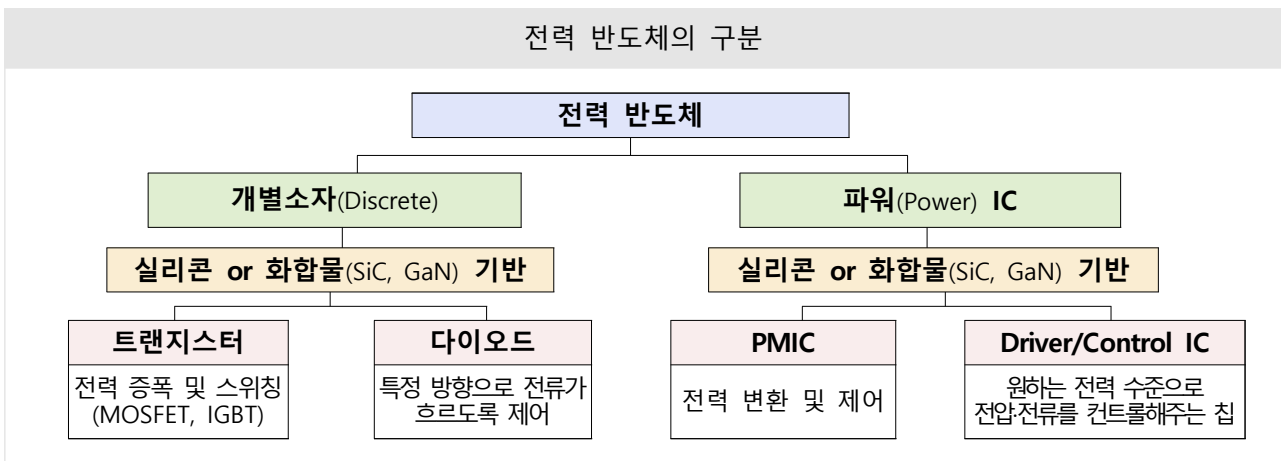
- 퀄컴, 엔비디아 등 미국의 대형 팹리스는 인텔의 경쟁사로 고객사 유치가 쉽지 않음
 - 200억불 규모의 2곳의 새로운 팹 신설은 TSMC, 삼성전자 또한 매년 투자하는 통상적인 수준으로 대규모 투자로 보기는 어려움
 - * 새로운 팹은 향후 파운드리 서비스보다 자체제품 생산비중이 높을 가능성 有
 - 인텔의 파운드리 팹 공장 착공이 올해 바로 시작한다 해도 공장 가동까지는 통상 2~3년의 기간이 필요
- (중장기적 영향) 미국이 제조역량 확보를 위해 인텔에 대규모 지원 지속 가능
- 인텔이 정부로부터의 대규모 지원을 발판으로 파운드리 산업 진출 및 7nm 이하 선단공정 양산에 성공할 경우 선두 TSMC를 추격하고 있는 삼성전자에게 점유율 확대에 향후 일부 부정적 영향 가능

2. 전력반도체 국내외 동향

○ 전력반도체 개요

■ (개념) 전기를 활용하기 위해 직류·교류 변환, 전압·주파수 조정 등 전력의 변환·변압·안정·분배·제어를 수행하는 반도체

○ 전력 반도체는 ①전력 반도체 개별소자와 ②파워 IC로 구분



○ 최근 Si(실리콘) 대비 전력 효율, 내구성이 뛰어난 SiC(실리콘카바이드), GaN(질화갈륨) 등 화합물 기반 차세대 전력 반도체가 新시장으로 부상 중

화합물 기반 차세대 전력 반도체의 특징

구분	특징
SiC	▶ Si 대비 10배 높은 전압 내구성, 30% 작은 전력손실 ⇒ 전기차, 태양광 인버터 등에 사용
GaN	▶ Si 대비 빠른 스위칭 속도, 소형화 가능 ⇒ 고속 무선 충전, RF 통신 등에 활용

■ (중요성) 전력 반도체는 AI, 5G 등 디지털 뉴딜과 전기차, 신재생 등 그린 뉴딜의 공통분모로 성장 가능성이 높은 분야

- ① (디지털 뉴딜) 전력의 제어 및 효율적 사용을 돕는 전력 반도체는 ①전자기기 기반의 디지털화, ②전자기기의 다기능화로 수요 증가
- ② (그린 뉴딜) 전력 효율과 고온·고압 내구성이 뛰어난 전력 반도체는 ①전기차 배터리, ②신재생 에너지 발전의 인버터 등에 필수 적용

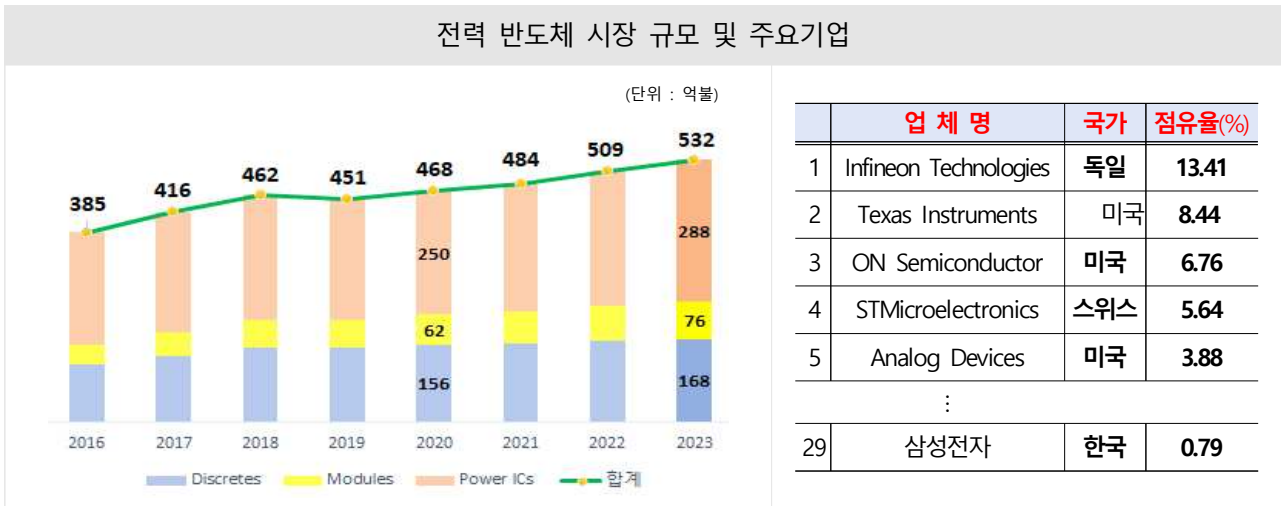
◆ 미래 수요 증가가 예상되는 전력 반도체 분야의 경쟁력 확보 필요

⇒ 특히, 초기 단계인 차세대 전력 반도체의 전략적 육성이 중요

글로벌 동향

■ (시장 동향) 글로벌 전력 반도체(소자, 파워IC, 모듈*) 시장 규모는 '19년 약 450억불에서 '23년 약 530억불 규모로 성장할 것으로 전망

* 모듈 : 개별소자와 파워 IC를 탑재하여 시스템에 장착 가능하도록 규격화



자료 | OMDIA('21.2))

○ 차세대 전력 반도체에 사용되는 SiC 웨이퍼 시장은 '19~'27년간 연평균 16% 증가하여, 3배 이상 성장할 것으로 예상

* '19년 218천장 → '27년 693천장 (출처, OMDIA)

■ (주요국 동향) 미국, 중국, 일본 등 주요국은 화합물 기반 전력 반도체 육성을 위해 다양한 정책적 지원 추진 중

① (미국) 美 에너지부를 통해 와이드밴드갭*(WBG) 반도체를 개발하는 '파워 아메리카(Power America)' 사업 출범('14) 및 추진 중

* 실리콘(Si) 대비 낮은 저항과 높은 고온 안전성 → SiC, GaN 등 화합물 기반 반도체

② (중국) '21년 양회에서 3세대 반도체(화합물 반도체)를 '7대 첨단 과학기술'에 포함시켜 자립화 한다는 계획 발표

③ (일본) 전략적 이노베이션 창조 프로그램('14)의 일환으로 차세대 파워일렉트로닉스 사업* 개시

* WBG 기반 웨이퍼 소재, 전력반도체 소자·모듈 및 응용기술 개발 추진

◆ 글로벌 주요국은 차세대 전력 반도체의 성장 가능성을 인지하고, 선제적인 지원 정책 추진 중

○ 국내 동향

- (지원 현황) 정부는 전력 반도체 기술력 제고를 위해 '17년부터 총 830억원 규모의 '파워반도체 상용화 사업*'을 추진 중

* 신산업 창출 파워반도체 상용화('17~'23년) : '21년 76억원

- 同 사업을 통해 Si 외에도 SiC, GaN 등 전력 반도체의 성장 기초*를 확보하였으며, 국내 유일의 6인치 SiC 시제품 제작 인프라**를 구축

* R&D 과제를 통해 '18~'20년간 총 346억원의 조기 매출 창출 지원

** 부산 파워반도체 상용화 센터 : 부산대와 기장군에 SiC 반도체 제작 일괄공정 구축

- 이와 함께, ①전력 반도체 신뢰성 평가 인증센터('19~'22), ②차세대 전력반도체 소자 제조 전문인력 양성('20~'24) 등 성장 기반 지원 중

- '21년부터 시제품 제작 인프라 확대를 신규 지원 중이나, 설계·공정 개발을 위한 전력 반도체 R&D 사업은 신규 과제 마련 필요*

* 신산업 창출 파워반도체 상용화 사업은 '20년부터 계속 과제만 지원

- (산업 동향) 국내 전력 반도체 시장은 약 20억불 규모이며, 기술력 부족과 해외 기업의 특허 선점으로 수요의 90% 이상을 수입에 의존

- (개별소자) 국내 기업의 생산 규모 및 기술력이 글로벌 대비 부족

- 모듈 기업은 소자 기업과의 연계 부족으로 수입 소자 탑재·개발 중

- (파워 IC) 국내 팹리스 기업을 중심으로 PMIC 등을 개발 중

- 최근 국내 주요 기업들은 SiC, GaN 등 차세대 전력 반도체의 성장 가능성에 주목하고, 관련 투자*를 확대 중

* ▲A社(韓) : SiC 웨이퍼 기업 B社(美) 인수('19), ▲C社(韓) : 소자기업 D社(韓) 지분투자('21)

- ◆ 화합물 기반 차세대 전력 반도체 시장에 선제적으로 도전하기 위해 민·관 공동 노력이 필요한 시점

⇒ 차세대 전력 반도체 기술력 확보를 위한 신규 R&D 적기 추진 필요

3. LG전자의 스마트폰 사업 철수, 누가 기회를 차지할 것인가?

LG전자가 4월 5일 오전 이사회를 열어 7월 31일자로 모바일 사업을 종료하기로 결정했다고 밝혔다. LG전자는 매각을 위해 베트남 빈그룹, 독일 폭스바겐 등과 논의를 진행했으나 가격 차이 등으로 합의에 이르지 못한 것으로 보이며, 철수 이외에 달리 대안이 없었던 것으로 보임.

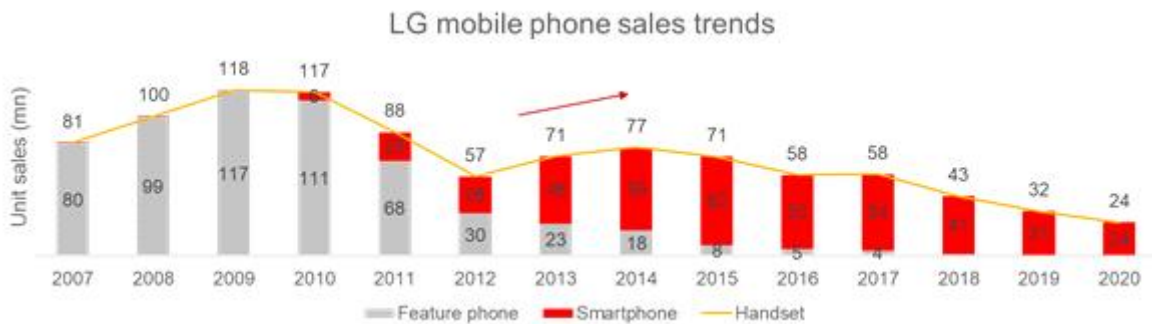
LG전자의 사업 철수로 글로벌 모바일 시장에는 빈자리가 발생하게 되며, 이를 차지하기 위한 삼성, 모토로라, HMD, 샤오미 등의 경쟁이 예상됨. 이 보고서에서는 LG전자 모바일 사업을 간략히 요약 및 분석하고, 나아가 사업 철수가 글로벌 시장에 미칠 영향을 분석, 이후 사업에 대해 전망해보고자 함.

LG전자 사업 요약

■ LG전자 사업 철수 배경

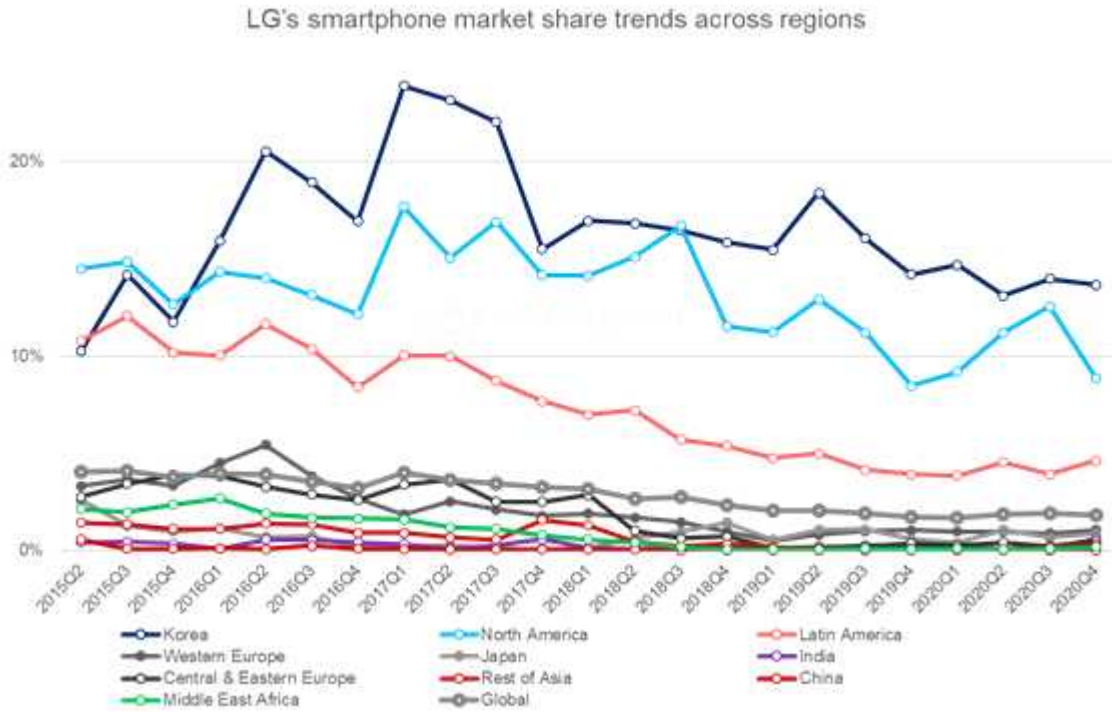
1995년 이래로 26년간 지속해온 모바일 사업은 2008년 세계 3위 휴대폰 제조사로 자리매김했으나, 2010년 스마트폰 시장 진출이 늦어지며 경쟁사 대비 뒤쳐진 평가를 받았음. 이후 2013년 G시리즈를 통한 재기를 노렸으나 이미 애플의 아이폰이 출시된 지 6년, 삼성의 갤럭시S가 출시된 지 3년이 지난 시기였음. 2015년 2분기부터 지난해 4분기까지 23분기 연속 적자를 기록했고 누적 적자 규모는 5조원에 달했음.

2009-2010년 '피쳐폰 시대'를 이끌며 모바일 사업 최고치를 달성했으나, 이후 지속적인 감소세를 이어왔음. 2017년 실험적으로 출시한 모듈형 스마트폰 G5 이후 LG전자의 출하량이 급격하게 감소하기 시작했으며 특히, 2019년 V50 ThinQ와 2020년 Wing과 같은 실험적인 제품의 연속 출시의 결과는 출하량 감소로 이어져 약 2,440만대까지 축소되었음.



■ LG전자 국가·지역별 점유 현황

출하량이 줄어들면서 LG전자는 모바일 사업을 북미, LATAM과 한국 시장으로 대표되는 통신사 위주의 일부 시장으로 점차 축소 운영해왔기 때문에, 사업에서 철수하게 되면 글로벌 스마트폰 시장 점유율에는 2% 정도의 공백이 발생하게 됨. LG전자 모바일 사업의 대표적인 특징은 다수의 공급층이 존재하는 시장에서 직접 공급을 하지 않고 이동통신사와의 계약을 통해 제품을 판매함. 삼성이 전자의 방식을 성공적으로 활용했던 것과는 달리, LG전자는 사업의 규모 및 비전 등 많은 측면에서 부족함을 극복하지 못했음.



Source: Counterpoint Research, Mobile Handsets Market Monitor, Feb 2021

북미와 중남미는 LG의 판매량의 80% 이상을 차지, LG의 모바일 사업은 소수 주요 전략지역에 대한 높은 의존도를 보였음. 그러나 전략지역에서의 점유율 역시 감소하며, 주력 시장에서도 강한 경쟁 위협을 받아온 것으로 보임. LG는 여러 해에 걸쳐 다양한 전략을 시도, 재정비를 통해 변화를 꾀하고자 하였으나, 근본적인 판매량의 감소세를 극복하는 데에는 성공하지 못했음.

■ 북미 시장 분석

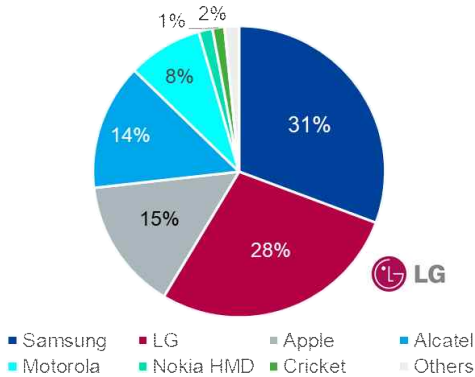
LG전자는 프리미엄 플래그십 제품군에서 지속적인 판매 부진을 겪은 한편, 중저가 스마트폰 판매는 충분한 수익을 창출하기에 부족했음.

Verizon, AT&T, T-Mobile와 같은 대형 Postpaid (후불제 휴대폰) 채널에서 LG전자의 점유율은 지속적으로 감소하여 2020년에는 5% 수준에 머물렀음. 플래그십 제품의 경우 출시 후 두 달 이내에 모멘텀을 잃었으며 삼성과 애플의 거대한 마케팅 투자액을 극복하는 것은 불가능에 가까움.

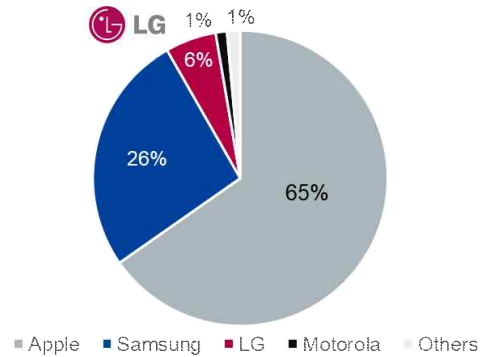
또한 모듈형 스마트폰 출시와 소프트웨어 오류, 출시 연기 등의 문제가 연속적으로 발생하자 기업의 신뢰도는 낮아졌으며, 높은 반품률 또한 Postpaid 부문 LG전자의 부진에 영향을 미쳤음. AT&T 채널 등에서는 높은 할인율을 적용, 제품 가격을 크게 인하하기도 하였으나 판매량은 기대에 미치지 못했고, Verizon에서의 판매량 및 평가 또한 낮은 수준에 머물렀음.

이에 비해 Prepaid(선불제 휴대폰) 부문에서는 비교적 높은 경쟁력을 유지했음. 2020년 북미 Prepaid 채널 점유율 28%를 달성, 삼성에 이어 점유율 2위를 차지했음. LG Stylo 6 판매량은 200만대를 넘어서며 높은 판매량을 기록하였지만, 수익성의 문제를 모두 해결하지는 못했음.

Prepaid carrier share by OEM 2020



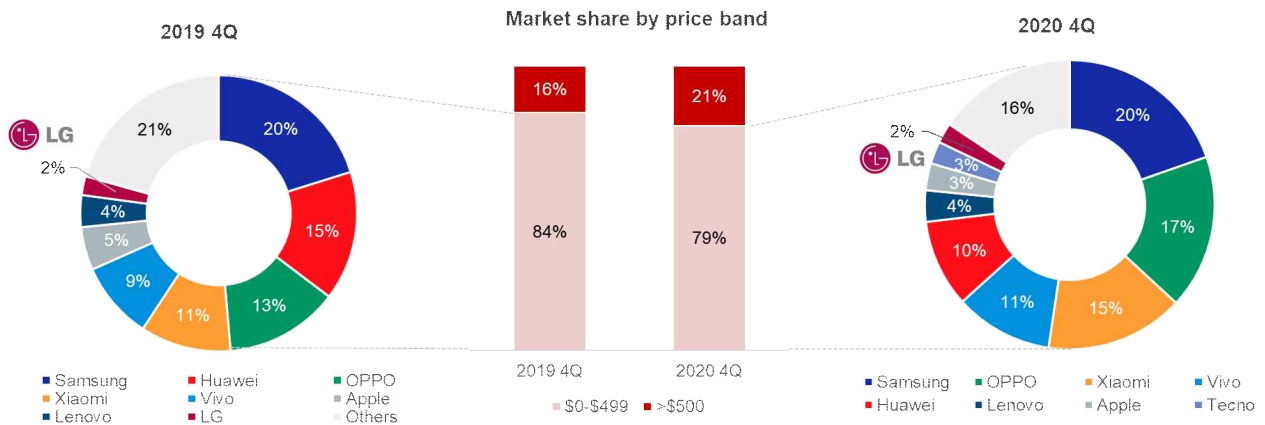
Postpaid carrier share by OEM 2020



■ LG전자 가격대별 판매 현황

LG전자 휴대폰 가격대별 판매 비중을 보면, 2020년 4분기 기준 500달러 이상(도매가 기준) 모델의 판매 비중은 5%로 전년 동기 대비 5%p 감소했으며, 그 이하 중저가 및 저가 모델 판매 비중은 각각 2%p씩 증가한 것으로 나타났음. 고가 플래그십 위주로 알려진 국내의 이미지와 달리 글로벌 시장에서의 고가 제품군의 판매는 부진했으며, 중저가 위주의 판매가 지속된 것으로 보아 지속적인 수익률 악화를 경험한 것으로 해석할 수 있음.

하지만, 비교적 최근 집중적으로 공략하기 시작한 중저가 시장의 경우 샤오미, 오포, 비보 등 중국 브랜드와 더불어 기존의 모토로라와 TCL 등, 많은 브랜드 간 경쟁이 과열된 상태였음. 나아가 삼성, 애플 등 프리미엄 브랜드의 중저가 시장 진입이 이루어지며 시장 점유율을 차지하기 위한 경쟁은 더욱 심화되었음.



○ 주요 시장 내 LG전자 공백 영향

■ 북미(US) 시장

북미 지역 내 LG의 스마트폰 판매는 대부분 \$299 이하 제품군에서 이루어졌음. LG가 9%의 점유율로 3위를 기록하고 있는 북미지역의 경우, 삼성이 중저가대의 A시리즈를 통해 빈자리 일부를 차지할 것으로 보임. LG와 유사한 제품 라인업을 갖추고 있는 모토로라, HMD를 비롯하여 TCL, ZTE, Vinsmart 등도 수혜 대상임.

■ 중남미(LATAM) 시장

중남미 시장 역시 \$299 이하 가격대 비중이 2020년에 67%로 가장 컸으며, LATAM 지역에서는 모토로라와 샤오미가 LG의 공백 대부분을 차지하게 될 것으로 예상됨.

■ 국내 시장

한국 시장에서는 삼성과 올해 한국 시장에 재도전하는 샤오미가 LG의 공백을 메울 것으로 보이며, 특히 글로벌 시장에서도 새로운 플래그십 제품인 Mi11 프로 및 Mi11 울트라 모델을 공개하는 등 공격적인 전략을 구사하며 눈도장을 찍고 있어 행보가 기대됨. 또한 많은 국내 통신사들이 제품군을 넓히는 전략을 펼치고 있는 만큼 그 외 중국 브랜드들의 수혜 또한 예상됨.

○ 사업 철수 이후 LG전자 전망

LG전자는 모바일 산업에서 철수하면서도 "6G 이동통신, 카메라, 소프트웨어 등 핵심 모바일 기술은 차세대 TV, 가전, 전장부품, 로봇 등에 필요한 역량"이라며 "특히 2025년경 표준화 이후 2029년 상용화가 예상되는 6G 원천기술 확보에 박차를 가하겠다"는 말을 남겼음. LG전자는 기존 MC사업본부 연구개발 인력을 LG전자 CTO부문 등에 재배치하고, 특히 자동차 부문 등에서의 기술 혁신에 더욱 집중할 것으로 예상됨.

○ 결론

- ① LG전자가 수년 간 지속된 판매 악화의 결과 스마트폰 사업을 철수함. 사업 실패 요인으로는 뒤늦은 시장 진출, 구글이 아닌 마이크로소프트를 선택한 것과 모듈형 스마트폰 등의 실험적 제품 출시를 지속한 것 등으로 보임.
- ② LG전자의 철수로 인한 시장 공백은 주요 전략 지역이었던 북미, 중남미와 한국 시장을 중심으로 발생하게 되며 특히 \$100~\$299 가격대에서 가장 두드러질 것으로 예상됨.
- ③ LG전자의 철수로 인한 시장 공백은 기존 LG의 점유율이 높았던 북미에서 가장 크게 발생할 것임. 특히 중저가 모델들의 판매 비중이 높은 Prepaid (선불제 휴대폰) 채널에서 가장 두드러질 것임. 삼성은 중저가대의 A시리즈를 중심으로 기존 LG전자의 Prepaid 및 프리미엄 판매 부문 공백을 차지할 것임. 이 밖에도 LG전자의 빈자리를 차지하기 위한 HMD 글로벌, ZTE, 빈스마트, 알카텔 등의 경쟁이 예상됨.

중남미 시장에서는 모토로라, 샤오미가, 국내에서는 삼성과 샤오미의 수혜 가능성이 가장 높음.